

EPBOARD 0700

Епоксидна плита для оснастки

ЗАСТОСУВАННЯ

EPBOARD 0700 - термостійка епоксидна плита для оснастки, особливо придатна для виготовлення моделей форм для епоксидних препрегів при автоклавному процесі, композитної оснастки термічного відвердіння та форм вакуумного формування. Її також можна безпосередньо використовувати для виготовлення форм для малосерійних композитних деталей.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока стабільність розмірів • Високий опір крихкому руйнуванню
- Легка механічна обробка • Добра стабільність кромки
- Висока термостійкість • Низький КТР
- Низька густина • Якісна поверхня

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Продукт	EPBOARD 0700
Колір	Синій
Густина	0,70-0.75g/cm3

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Властивість	Стандарт випробування	EPBOARD 0700
Твердість	ISO868:2003	72 за Шором D
Температура прогину під навантаженням	DIN EN ISO 75B	130°C
Міцність на згин	ENISO178	36MPa
Модуль пружності при згині	ENISO178	2100MPa
Міцність на стиск	ENISO604	50MPa
Міцність на розтяг	ENISO527-1	23MPa
Модуль пружності при розтягу	ENISO527	2400MPa
Ударна міцність	ENISO179	5.3KJ/m2
Коефіцієнт лінійного теплового розширення	ENISO113590-2	39*10-6K-1

Температура (°C)	23	80	100	130	150
Твердість за Шором D	72	70	68	66	55

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОБРОБКИ:

Склеювання плит:

1. Розкроїть і підготуйте блоки, потім зберіть їх без клею для перевірки.
2. Відшліфуйте обидві поверхні стику наждачним папером зернистістю 320.
3. Здуйте пил стисненим повітрям, потім видаліть забруднення з поверхонь для склеювання відповідним розчинником, наприклад ацетоном.
4. Перед склеюванням дочекайтеся випаровування залишків розчинника.
5. Зубчастим шпателем рівномірно розподіліть приблизно 600 г епоксидного клею по обох поверхнях стику.
6. З'єднайте дві покриті свіжим клеєм поверхні й рівномірно притискайте, доки клей не почне виходити зі стику. Видаліть надлишок і перевірте, що товщина клейового шва рівномірна та не перевищує 1 мм.
7. Зафіксуйте плити легким затисканням або вантажем по всій верхній поверхні пакета, щоб забезпечити рівномірний тиск на всю плиту.
8. Перед подальшою механічною обробкою завжди дайте клею достатньо часу для відвердіння.
9. Для досягнення максимальних теплових характеристик системи рекомендовано довідвердіння.
Рекомендовано охолоджувати деталь в автоклаві до кімнатної температури зі швидкістю не більш ніж 20 °C за годину. Це запобігає термічному удару плити та клею, який може спричинити слабе з'єднання й тріщини в плиті від напружень.

Опора:

Плита має бути достатньо підтримана, щоб уникнути надмірних напружень від власної ваги. Для великих моделей рекомендовано сталевий опорний каркас, який зменшує прогин і полегшує переміщення. Для кріплення опорних або каркасних конструкцій до плити використовуйте один із рекомендованих клеїв. Механічні кріплення високотемпературних плит потребують обережності: різниця коефіцієнтів теплового розширення може спричинити короблення або мікротріщини при нагріванні й охолодженні.

ДОСТУПНІ РОЗМІРИ ПЛИТ

1500*500*50mm

1500*500*75mm

1500*500*100mm

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ПОВОДЖЕННІ:

Працюйте в добре вентильованому приміщенні. Під час обробки уникайте контакту зі шкірою та використовуйте рукавички, маску, захисні окуляри й одяг. Додаткову інформацію наведено в паспорті безпеки матеріалу.

08-2024 EPBOARD 0700 Сторінка 2/3

ПРИМІТКА:

Наведені вище дані отримано за визначених умов випробувань. У практичному застосуванні процедури й умови можуть відрізнятися, тому перед використанням за потреби слід провести випробування та переконатися, що продукт відповідає фактичним вимогам. EPTEK гарантує відповідність продукції своїм найвищим нормам управління якістю.

08-2024 EPBOARD 0700 Сторінка 3/3